

參加第 13 屆政府間半導體會議 (GAMS) 出國報告

壹、背景說明

政府間半導體會議 (Governments/Authorities Meeting on Semiconductors, GAMS) 源於國際間半導體產業之對話論壇，係當前半導體產業最重要之政府間國際會議，共有 6 個成員，其中美國、歐盟、日本及韓國等 4 國為創始會員，我國及中國大陸分別於 1999 年及 2006 年加入。GAMS 會議每年均由 6 個成員政府針對各國半導體產業協會所組成的世界半導體理事會 (WSC) 提出之各項建言逐一研商回應；會議之目的，係期望透過此一對話機制，達到協助解決半導體產業經營所遭遇的困難、排除貿易障礙，並進一步推動有利產業發展的公平競爭環境。

第 13 屆 GAMS 會議於本(101)年 9 月 27 日在德國柏林舉行，主要針對本年 5 月 24 日 WSC 在美國紐約州薩拉託加溫泉市舉行的第 16 屆 WSC 年會中，產業界所提出對各國政府的建議進行廣泛討論，討論主題包括多元件積體電路 (MCO) 產品定義與免稅待遇、擴大多晶片積體電路 (MCP) 免稅協定之涵蓋對象、加密標準與規範、進出口規範限制、共同合作保護全球環境、衝突礦石、智慧財產權保護及區域振興經濟措施等議題。另 GAMS 並依據 WSC 之建議，於本年大會前 2 天召開海關專家技術性會議，就 MCO 產品定義進行研商，以利就 MCO 定義內容及推動免關稅議題達成共識。

貳、會議過程

本(第 13)屆 GAMS 會議由歐盟執委會貿易總署負責市場進入、產業、能源及原物料之 Petros SOURMELIS 處長主持，GAMS 各成員均派員參加，我國係由經濟部國際貿易局江副局長文若率團出席（各國出席人員名單詳如附件 1）。

本次會議期間，我與會代表團除出席 GAMS 大會及會前舉辦之海關專家多元件積體電路(MCO)技術性會議外，並於大會召開之前分別與美國、歐盟及日本等 GAMS 成員進行雙邊會談，同時與台灣半導體產業協會(TSIA)與會代表就各議題溝通研商，進一步瞭解產業界關切事項之最新進展。重要活動行程臚列如下(詳如附件 2)：

- | | |
|-------------------|--|
| 101 年 9 月 25-26 日 | 出席海關專家 MCO 技術性會議 |
| 101 年 9 月 26 日 | 與美國、歐盟、日本代表團雙邊會談
與台灣半導體產業協會(TSIA)與會代表會商 |
| 101 年 9 月 27 日 | 出席政府間半導體會議(GAMS) |

參、重要討論情形

一、海關專家多元件積體電路(MCO)技術性會議

本次 MCO 技術性會議 GAMS 各成員除韓國以外均派員參加。由於 GAMS 係以世界半導體理事會(WSC)本年 5 月達成共識之 MCO 定義版本為基礎進行討論，爰會議安排首先邀請 WSC 簡報，並由 GAMS 就定義內容向 WSC 提問，釐清

相關技術性事項後，續進入 GAMS 之內部討論。經過連續 2 天的技術性研商，除中國大陸以外，包括我國在內其餘 5 個 GAMS 成員，對於進一步修訂後之 MCO 定義內容均已達成共識。惟因中方堅持不同意 MCO 定義中納入微機電系統 (MEMS)，因此，GAMS 未能於技術性會議中作成具體結論。相關會議情形詳見附件 3。

二、雙邊會談：

本次 GAMS 會議前，我方分別與歐盟執委會貿易總署 Petros SOURMELIS 處長、日本經產省商務情報政策局審議官中山亨及美國貿易代表署副助理貿易代表 Barbara NORTON 進行雙邊會談，就雙方關切事項包括 MCO、區域振興經濟措施、智慧財產權保護及衝突礦石等議題之立場及 GAMS 大會可能達成之成果交換意見，相關重點如下：

(一) MCO 定義與免稅待遇

鑒於 MCO 議題已討論多年，GAMS 各成員方均希望今年會議能有具體結果，爰針對中國大陸堅持 MCO 不應納入 MEMS 一節，我方於雙邊會談時進一步詢問歐、美、日對於倘中方未能同意該定義，其後如何將定義提交至 ITA 擴大談判，以及在未獲中方支持下，未來 ITA 針對 MCO 產品談判難度可能增高之看法。對此，歐方表示，GAMS 對此議題之處理有二種可能方式，其一為先同意較限縮之 MCO 版本，再透過後續的討論逐步擴大產品範圍，其二為就目前版本達成僅 5 個成員支持之共識版本。美國則認

為本議題經數次討論，爰傾向將 5 個國家達成共識版本送到 ITA 討論，或許可出現契機。而日本也主張 GAMS 應先維持保留原 MEMS 內涵之完整版本。

另針對 WSC 建議將 MCO 定義納入 2017 年調和關稅稅則之檢視修訂一節，美方則表示，推動時程上可能太急促。

(二) 區域振興經濟措施

由於會前從我國 TSIA 及日方瞭解歐盟與美國產業界 (ESIA 與 SIA) 可能就此議題建議 GAMS 建立一溝通機制，將預訂對艱困企業 (failing company) 採行之紓困措施通報 GAMS 成員，並應 GAMS 各方要求進行諮商，爰我方於雙邊會談時亦就此議題瞭解美、歐、日本意向，並說明我國認為 WTO 補貼協定 (ASCM) 已有清楚的規範與通知機制，認為不應增加不必要的負擔之立場。

由於日本業界對本案反對最烈，爰日方對於我方就此議題與其有一致之看法並表示感謝。日方認為 WSC 針對本案並無共識，爰 GAMS 很難進一步討論。此外，日方指出，政府採行之振興措施多為整套的政策方案，其中可能包含 R&D 及產業發展計畫，實務上很難指出哪一項措施係針對艱困企業之紓困，加以企業之經營經常有反敗為勝之案例，政府倘冒然認定某一家廠商屬艱困企業並向其他國家提出通知，對企業恐將產生負面影響。

惟歐盟則認同其業界之建言，並表示目前 WTO 的機制缺乏效率，所以認為其業者所建議的預先通知機制，有助提升監督的效率；對於歐方的看法，我方回應建議應回歸

WTO 場域就相關通知機制之改善進行討論。另美國則傾向鼓勵業者持續討論，以利 GAMS 進一步研議，並詢問我方可否支持；我方回應表示，可同意 WSC 持續討論，惟認為 GAMS 應無需進一步「鼓勵」業者討論此議題。

(三) 智慧財產權保護

鑒於專利品質改善對維護我半導體產業之重要性，我國除於會談中表達對此議題之重視，以及希望 GAMS 成員對 WSC 與 WIPO 共同合作推動改善專利品質繼續予以支持外，並進一步說明我智慧財產局亦致力於專利品質改善相關工作，並願與 GAMS 各方進一步合作。美、日、歐各方除均認同本議題之重要性外，歐方並進一步詢問我方對韓國可能提出專利蟑螂議題的立場，我方回應表示支持討論 NPEs 所造成的相關問題。

(四) 衝突礦石

由於我國業者擔心美國在本年 8 月公告之「金融改革及消費者法」最終施行辦法，對於使用衝突礦石之揭露要求可能對半導體製造商帶來額外的支出與負擔，因此我方除於雙邊會談時向美方表達我業者之關切外，亦就業者希望瞭解該法對於合理來源查詢的查核義務程度進一步詢問美方。美方除提出相關說明外，亦表示該法將於明年 1 月生效，建議我業者倘有相關疑義可進一步向美國證券交易委員會洽詢。

另我方亦利用與日本會談之機會，瞭解日方對美國前揭措施可能影響之看法。日方表示，由於該施行辦法頃於本年

8月公佈，爰尚未詢問業界意見，惟因其影響範圍不限於半導體產業，因此，日方規劃將邀集包括機械及汽車等相關產業業者進一步討論。

三、政府間半導體會議(GAMS)

本年 GAMS 會議循例先由 WSC 與會代表針對向政府提出之各項建言進行簡報(詳附件 4，並由各國 GAMS 代表致開幕詞後(我團團長致詞稿詳附件 5)，就各項議題進行研商。有關重要議題包括推動 MCO 免稅、MCP 議題、加密標準與規範、進出口規範限制、共同合作保護全球環境、衝突礦石、智慧財產權保護(反仿冒、改善專利品質)及區域振興經濟措施等之討論情形與會議結論，說明如下：

(一) MCO 議題

由於中國大陸續堅持去年立場不願將 MEMS 納入 MCO 定義，並就定義內容再度提出其他意見(註：針對中方意見 WSC 於會中回應如附件 6)，且其於大會討論時另強調 MEMS 並不屬於 GAMS 應討論之半導體產品範圍，爰各成員並未採納中方所提排除 MEMS 版本，其後再隨科技發展逐步增列 MEMS 項目之建議。

關於本議題，我方亦表達貿易自由化對產業發展之重要性，並說明排除 MEMS 無法符合產業界之需求，因此支持以目前的 MCO 版本推動下一步的貿易自由化工作。

經冗長討論後，主席建議採納 WSC 全體業界同意，以及除中國大陸以外 GAMS 共 5 個成員達成共識之 MCO 定義版本，並獲 5 個成員同意，共同將定義內容進一步提送 ITA

擴大談判納入清單。對於中方未能同意加入一節，則於主席總結建議中方重新考慮其立場。

(二) MCP 議題

針對 WSC 多年來一直期盼擴大 MCP 協定之參與成員，及要求 GAMS 成員均能簽署 MCP 協定之建議，歐盟鑒於此議題已於 GAMS 討論多年，爰建議本次會議作成結論，將 MCP 納入多邊協定為達成此一目的較為務實之方式，並獲各成員同意。

(三) 加密標準與規範

針對本項議題，我國表示支持 WSC 有關透明化原則之倡議，並強調遵守 WTO 規範與國際標準及鼓勵創新之重要性，同時呼籲 GAMS 各成員共同努力進一步強化相關法規特別是新擬議法規在訂定過程之透明化。對於我國強調之透明化原則，美國、韓國、日本及中國大陸均接續發言表達同意我方之看法。會議總結 GAMS 將與 WSC 就有關國內市場商業加密之輸入、生產與使用相關法規發展相互提供最新資訊，並請 WSC 定期將所蒐集之相關法規與貿易資訊提供予 GAMS 參考。

(四) 進、出口規範限制

本項議題主要針對高科技產品之管制，會中中國大陸特別強調不應對進出口有不平等之待遇或限制，並表示希望於主席總結納入以對等公平原則支持高科技發展相關文字；另美國及歐盟則分別就其等與中方就此議題之合作情

形提出說明。本議題 GAMS 會議總結除支持 WSC 有關促請政府建立良好環境，以利高科技產品民間貿易發展之倡議外，並表達願意與產業就相關法規發展及進出口議題進行溝通與資訊交流。

(五) 共同合作保護全球環境

對於 WSC 在推動半導體產業節能及減少溫室氣體排放方面的工作進展，GAMS 各成員均表示歡迎，另中國大陸對於相關數據的正確性，認為應進一步檢視，韓國、日本與美國則指出應請產業界繼續提供更多資訊，以利 GAMS 瞭解相關量化目標之達成情形；此外，包括我國、日本及韓國均對 WSC 所提相關建議表示支持或歡迎，我方並進一步強調贊同產業界有關促進法規調和重要性之看法，同時強調法規之規範應顧及產業界的實務運作。

依據各成員之意見，主席總結除對 WSC 之建言表示瞭解外，並指出持續的監督與報告工作，對增進全氟化物(PFC)自願減量成果可信度之重要性。

(六) 衝突礦石

對於 WSC 籲請各國政府主管機關將產業界之建議納入考量，以鼓勵「非衝突(conflict free)」產品之貿易，GAMS 於本次會議中允諾將該等建言轉知各成員國負責相關議題之主管官員。

(七) 智慧財產權保護

本項議題 GAMS 各成員除重申對保護智慧財產權之承

諾，並對 WSC 承諾強化反仿冒相關工作以及與世界智慧財產權組織(WIPO)在改善專利品質上的合作表示支持外，美方另呼籲加強海關及執法機關合作參與之重要性，而中國大陸強調應將「垃圾專利」擾亂半導體產業發展納入主席結論。我國針對改善專利品質議題，並進一步建議各國專利主管機關可進一步分享與處理專利申請相關的統計數據，以協助 WIPO 統一收集相關資訊，俾未來能透過採納共同的指標，統一專利審查品質標準，達到進一步改善專利品質之目的。

最後主席總結指出，GAMS 將與海關及執法機關合作，透過如資訊分享等方式強化智慧財產權保護之落實，並重申對各成員政府間持續深化專利辦公室合作，以強化專利品質之支持。針對各專利主管機關間就專利品質之合作事項，GAMS 特別強調以下工作之重要性：分類調和、專利審核方法、資訊交換、審核人員訓練，及強化有關處理專利申請以及改善機械式翻譯系統相關工作之協調等。至於非專利業者(專利蟑螂)議題，GAMS 對 WSC 之討論持開放立場，並請 WSC 將相關研究簡報資料提供 GAMS 參考(如附件 7)。

另 GAMS 對於 WSC 強化反仿冒相關工作之承諾亦表示支持，同時指出包括執法機關間的資訊分享、人員培訓、提高執法人員以及產業界對於仿冒可能對人類健康、公共安全及重要基礎建設產生的風險之瞭解等，對打擊仿冒工作具關鍵重要性。此外，本次會議期間中國大陸並針對其反仿冒措施提出報告(按：中方為去年唯一未提出報告之成員)，另美、歐兩國亦就反仿冒工作之相關進展提出說明。

(八) 區域振興經濟措施

本項議題雖美國與歐盟產業界原擬提議之溝通機制未能於 WSC 達成共識，惟日方為免本議題持續發酵，對於主席總結相關文字之呈現仍相當謹慎，並於會議期間針對文字修訂尋求我方聲援。最後主席總結指出，GAMS 注意到 WSC 內部持續就區域振興經濟議題進行討論，其中包括建置一政府對艱困企業提供援助之預先通知機制；並重申 WSC 應先就本議題特別是在通知、諮商程序及有關政府對半導體支持計畫相關資訊交換方式等與 WTO 補貼協定相關議題，就產業關切之關鍵事項與問題進一步釐清。

肆、結論與建議

本年 GAMS 會議雖中國大陸仍未能同意 MCO 之定義內容，惟其餘 GAMS 成員最終能就 MCO 之定義，以及後續共同透過 ITA 談判推動 MCO 產品免關稅達成共識，回應產業界 6 年來之期待，為會議之重要成果，WSC 並對 GAMS 表示感謝。至於其他產業界關切之重要議題，GAMS 亦均通過會議主席總結(如附件 8) 作出具體回應。

觀察本年會議討論情形，可見如何透過政府間之協調與合作，進一步促進法規調和與透明化，降低產業界不必要之負擔，為半導體產業日益重視之議題。而 GAMS 各成員對於產業之建言亦相當重視，特別是在智慧財產權保護議題上，GAMS 各成員均希望透過相關政府機關間進一步合作，加強仿冒查緝及提升專利品質，爰建議我國海關及智慧財產局亦可就該等議題於適當之場域深化與 GAMS 成員之合作交流。

另針對我國業者擔心可能造成額外負擔之美國衝突礦石規範議題，GAMS 大會上並無實質討論，主要係因美國頃於本年 8 月公佈最終施行辦法，產業界對該法內容之影響尚無具體定論。惟據瞭解，日本因該法影響範圍不限於半導體產業，將規劃邀集包括機械及汽車等相關產業業者進一步討論，爰建議我相關主管機關與產業界持續合作，並注意相關發展(按：貿易局前業將我駐美經濟組蒐集之相關資訊轉送工業局、投資處及我半導體產業協會等單位參考)。

本次會議我方針對產業界關切之議題，均事先透過雙邊會談之方式，與其他成員國預先溝通並爭取支持，以利 GAMS 會議達成有利我國產業發展之結論。未來政府將持續與業界(台灣半導體產業協會)充分合作，透過此一重要國際平台，改善半導體產業之國際經營環境並促進產業成長。